附件1：

2020年第一批半导体材料国标及国标外文版项目计划

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采标  情况 | 项目周期（月） | 技术归口单位 | 主要起草单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达第一批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]11号，2019年3月25日） | | | | | | | | | |
| 1 | 20190796-T-469 | [硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=122381&stage=plan) | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 有研半导体材料有限公司 |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达第二批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]22号，2019年7月8日） | | | | | | | | | |
| 2 | 20192102-T-469 | 集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 有研半导体材料有限公司 |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达2019年第三批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]29号，2019年10月17日） | | | | | | | | | |
| 3 | 20193166-T-469 | 氮化镓单晶衬底片晶面曲率半径测试方法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州纳维科技有限公司 |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达<防盗保险柜（箱）>等513项国家标准外文版计划的通知》（国标委发[2019]35号，2019年12月6日） | | | | | | | | | |
| 4 | W20191126 | 太阳能电池用多晶硅片 | 推荐 | 翻译 |  |  | 12 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、扬州荣德新能源科技有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 |
| 5 | W20191128 | 太阳能电池用铸造多晶硅块 | 推荐 | 翻译 |  |  | 12 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、扬州荣德新能源科技有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达2019年第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]40号，2019年12月31日） | | | | | | | | | |
| 6 | 20194171-T-469 | 高纯锑 | 推荐 | 修订 | GB/T 10117-2009 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 峨眉山市峨半高纯材料有限公司 |
| 7 | 20194172-T-469 | 刻蚀机用硅电极及硅环 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 有研半导体材料有限公司 |
| 8 | 20194173-T-469 | 硅片翘曲度和弯曲度的测试 自动非接触扫描法 | 推荐 | 修订 | GB/T 32280-2015 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 有研半导体材料有限公司 |
| 9 | 20194174-T-469 | 电子级多晶硅 | 推荐 | 修订 | GB/T 12963-2014 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 |
| 10 | 20194175-T-469 | 磷化镓单晶 | 推荐 | 修订 | GB/T 20229-2006 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达2020年推荐性国家标准计划（修订）的通知》（国标委发[2020]6号，2020年3月6日） | | | | | | | | | |
| 11 | 20200798-T-469 | 磷化铟单晶 | 推荐 | 修订 | GB/T 20230-2006 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
| 12 | 20200799-T-469 | 碳化硅单晶抛光片 | 推荐 | 修订 | GB/T 30656-2014 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
| 13 | 20200800-T-469 | 硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法 | 推荐 | 修订 | GB/T 24581-2009 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 乐山市产品质量监督检验所 |
| 14 | 20200801-T-469 | 硅单晶退火片 | 推荐 | 修订 | GB/T 26069-2010 |  | 18 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 有研半导体材料有限公司 |